

第2【事業の状況】

1【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）を取り巻く事業環境は、昨年度に引き続き安定的に推移しております。原油価格の高騰や米国での金利上昇については落ち着きを取り戻し、世界経済への影響も限定的なものと考えられます。国内経済は、好調な企業業績を反映した設備投資の増加や堅調な個人消費に支えられ、堅実に成長しつつあります。

IT投資については、海外では依然好調を維持しており、国内でも、企業マインドが成長戦略に転じるなかで、積極的な投資が増えはじめるとともに、金融商品取引法（日本版企業改革法）などへの対応に向けた投資も増加しはじめました。業種別では金融分野を中心に製造・流通分野なども活発化し、一部を除いて地域経済も回復していることにより、徐々に投資が上向きつつあります。

こうした状況の中で、当中間連結会計期間におきましては、売上高は2兆3,623億円（前年同期比7.8%増）となりました。国内では、前年同期比で投資が大きく減少した携帯電話基地局や、需要の低迷した個人向けパソコンが伸び悩みましたが、金融や製造・流通分野を中心にソリューション/SI（システムインテグレーション）事業が回復を示したほか、携帯電話やLSI、電子部品が増収となりました。海外では、英国や北米のサービスビジネスが好調であったほか、光伝送システム、HDD（ハードディスクドライブ）、電子部品などが増収となりました。

営業利益は506億円（前年同期比30億円増）となりました。海外における事業の拡大や、積極的な研究開発投資により、販売費及び一般管理費が増加したものの、海外を中心にサービスビジネスが好調であったことや、HDDや携帯電話などのコスト効率の改善が売上総利益の増加に貢献し、増益となりました。

経常利益は、退職給付積立不足償却額の減少や金融収支の改善により営業外損益が改善したことから376億円（前年同期比217億円増）となりました。

この結果、当期純利益は148億円（前年同期比71億円増）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりです。なお、各セグメントの売上高はセグメント間の内部売上高を含めて表示しております。また、当中間連結会計期間より営業費用の配賦方法を変更いたしました。このため前年同期比較にあたっては、前中間連結会計期間の数値を組み替えて表示しております。なお、当該変更の内容及び理由については、「第5 経理の状況 1. 中間連結財務諸表等 (1) 中間連結財務諸表 注記事項（セグメント情報）〔事業の種類別セグメント情報〕（注）4」に記載しております。

1. 事業の種類別セグメント

a. テクノロジーソリューション

テクノロジーソリューションは、最先端の技術に基づいた高性能・高信頼のIT基盤である「システムプラットフォーム」と、これらを活用した各種サービスなど、企業・官公庁のお客様向けの「サービス」により構成されます。

テクノロジーソリューションでは、お客様との長期的なパートナーシップに基づき、IT基盤の構築から、コンサルティング、システムインテグレーション、アウトソーシングに至るまで、お客様のライフサイクル全般にわたるトータルソリューションを提供し、当社グループの中心ドメインとして利益と成長を追求しております。

当中間連結会計期間における売上高は、国内では9,429億円（前年同期比0.8%減）、海外では4,857億円（同23.3%増）となり、全体では1兆4,286億円（同6.3%増）となりました。国内では、携帯電話基地局が減収となりましたが、ソリューション/SI事業が増収となり、全体ではほぼ前年同期並みとなりました。海外では、アウトソーシングなどのサービスビジネスが好調に推移したほか、光伝送システムやUNIXサーバなども伸長し、大幅増収となりました。

営業利益は364億円（前年同期比6億円減）となりました。海外を中心としたアウトソーシングなどのサービスビジネスについては増益となりましたが、携帯電話基地局の減収影響のほか、サーバ関連や光伝送システムの価格競争激化や先行投資負担の影響があり、全体では前年同期並みとなりました。

①「システムプラットフォーム」

システムプラットフォームでは、コスト削減や効率化をさらに進めるため、開発・設計といった上流工程を含むバリューチェーン全体のものづくり革新に継続して取り組んでまいりました。また、IT基盤「TRIOLE」のグローバル展開を進めるとともに、海外における販売強化のため、お客様のシステム構築を支援するオープンシステムの検証施設（プラットフォームソリューションセンター）をこれまでの日本、欧州、米国などの6拠点に加え、平成18年4月に上海、同年6月に香港に開設いたしました。

当中間連結会計期間における売上高は、国内では2,375億円（前年同期比2.8%減）、海外では1,011億円（同14.5%増）となり、全体では3,387億円（同1.8%増）となりました。国内では、携帯電話基地局の需要が一巡し、減収となりましたが、海外では、光伝送システムやUNIXサーバが好調に推移し、増収となりました。

営業損益は、51億円の損失（前年同期比78億円減）となりました。携帯電話基地局の減収影響のほか、サーバ関連や光伝送システムの価格競争激化や先行投資負担の影響があり、減益となりました。

②「サービス」

サービスでは、国内においては、収益力の向上を図るため、プロジェクトマネジメントの強化及び安定的な収益が見込まれる運用サービスビジネスや、パッケージ・サービスビジネスの強化を進めてまいりました。また、海外では、ビジネスの拡大を図るため、地域に対応した戦略を積極的に展開してまいりました。

当中間連結会計期間における売上高は、国内では7,053億円（前年同期比0.1%減）、海外では3,845億円（同25.8%増）となり、全体では1兆898億円（同7.8%増）となりました。国内では、金融分野や製造・流通分野を中心にソリューション/SI事業が回復を示し、海外では、英国のアウトソーシングサービスが引き続き好調に推移したほか、北米のサービスビジネスが昨年度末の米国ラピダイト社などの買収に伴ない事業規模を拡大したことなどにより大幅増収となりました。

営業利益は、416億円（前年同期比71億円増）となりました。国内のソリューション/SI事業で商談提案活動などのさらなるビジネス拡大のための費用を増加させましたが、コストダウンや、海外のアウトソーシングなどのサービスビジネスの増収効果などにより利益を維持いたしました。

b. ユビキタスプロダクトソリューション

ユビキタスプロダクトソリューションは、個人のお客様向けを中心としたパソコン、携帯電話や、HDD（ハードディスクドライブ）などにより構成されます。

ユビキタスプロダクトソリューションでは、引き続き徹底したコスト削減を進め、収益力の向上に取り組んでまいりました。このほか、パソコンでは、セキュリティやAV機能の強化などによる付加価値の高い製品を投入し、販売拡大を目指しました。携帯電話ではユニバーサルデザインの機種を中心とした製品により、差別化を図りました。HDDでは、さらなる品質強化を図るとともに垂直磁気記録方式などの新技術への対応を強化いたしました。

当中間連結会計期間における売上高は、国内では3,350億円（前年同期比1.9%増）、海外では1,935億円（同14.2%増）となり、全体では5,286億円（同6.1%増）となりました。国内では、パソコンが個人向けの需要が低迷したことにより伸び悩みましたが、携帯電話は堅調に推移いたしました。海外では、パソコン、HDDが大幅増となり、増収となりました。

なお、パソコンの出荷台数は370万台（前年同期比0.8%増）、携帯電話の出荷台数は185万台（同10.1%増）、HDDの生産台数は1,449万台（同19.0%増）となりました。

営業利益は、199億円（前年同期比33億円増）となりました。パソコンやHDDが国内外で価格競争激化の影響を受けましたが、ものづくりの強化によるコストの削減効果や品質強化などにより、全体としては増益となりました。

c. デバイスソリューション

デバイスソリューションは、デジタル家電、自動車、携帯電話、自社のサーバなどに搭載されるロジックLSIや、関連する電子部品などにより構成されます。

デバイスソリューションでは、ロジックLSIへの経営資源の集中という事業方針のもと、90/65nmテクノロジーを用いた先端ロジック事業とそれ以外の基盤ロジック事業のバランスをとりながら、収益力の拡大を目指しております。当中間連結会計期間には、三重工場の300mmウェーハ採用のロジックLSI量産第1棟（300mm第1棟）において製造能力を増強したほか、300mm第2棟の建設に着手いたしました。また、基盤ロジック事業の強化を図るため、平成18年9月にスパンション・ジャパン社より同社国内半導体工場の一部を購入する契約を締結いたしました。

当中間連結会計期間における売上高は、国内では2,156億円（前年同期比13.0%増）、海外では1,613億円（同11.0%増）、全体では3,769億円（同12.2%増）となりました。自動車向け及びデジタル家電向けを中心としたロジックLSIの需要が堅調であったことに加え、300mm第1棟の本格稼働により売上が増加したことから、国内外ともに増収となりました。

営業利益は160億円（前年同期比35億円増）となりました。次世代技術の開発費の負担が増えましたが、ロジックLSIの増収効果や、その他電子部品が引き続き好調に推移したことにより、ほぼ前年同期並みとなりました。

d. その他

その他セグメントの売上高は、国内では1,703億円（前年同期比5.6%増）、海外では647億円（同31.0%増）と

なり、全体では2,350億円（同11.5%増）となりました。営業利益は49億円（同28億円増）となりました。

2. 所在地別セグメント

当社グループは、海外ビジネスを強化するため、平成18年6月にEMEA（欧州・中近東・アフリカ）、米州、APAC（アジア・パシフィック）、中国の4地域にそれぞれ権限を有する責任者を置きました。これに伴ない、従来の「欧州」を「EMEA」へ、「その他」を「APAC・中国」へと変更いたしました。

a. 日本

日本においては、携帯電話や電子部品などが好調に推移し、売上高は1兆8,969億円（前年同期比4.4%増）となり、営業利益は553億円（同68億円増）となりました。

b. EMEA（欧州・中近東・アフリカ）

EMEAにおいては、英国アウトソーシングサービスが引き続き好調に推移したことなどにより、売上高は3,323億円（前年同期比19.4%増）となり、営業利益は92億円（同29億円増）となりました。

c. 米州

米州においては、サービスビジネスが昨年度末の米国ラピダイト社などの買収に伴ない事業規模を拡大したことのほか、光伝送システムやUNIXサーバが好調であったことにより、売上高は2,130億円（前年同期比26.1%増）となりましたが、営業利益は、光伝送システムでの価格競争激化や開発費用の増加などにより、ほぼ前年同期並みの53億円（同1億円増）となりました。

d. APAC（アジア・パシフィック）・中国

APAC・中国においては、HDDやロジックLSIが好調に推移したことにより、売上高は3,888億円（前年同期比13.9%増）となりましたが、ノートパソコン向けHDDの価格競争激化などにより、営業利益はほぼ前年同期並みの70億円（同3億円増）となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間中の営業活動によるキャッシュ・フローは、ロジックLSIの償却費負担を吸収して利益が増加したことなどにより、1,840億円のプラスとなりました。前中間連結会計期間には受取和解金収入159億円があったことや、当中間連結会計期間の末日が休日であったため売上債権などの受取及び買掛債務などの支払が翌期に延伸となった影響752億円などにより前年同期比では410億円の増加でした。投資活動によるキャッシュ・フローは1,190億円で、主に三重工場300mm第1棟の生産能力増強投資によるものです。前年同期比では148億円の支出増となりました。この結果、フリー・キャッシュ・フローは、期末日が休日であったことの影響を含めて650億円のプラスとなりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還1,000億円などにより735億円のマイナスとなりました。

なお、前中間連結会計期間のキャッシュ・フローと当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの比較は、次のとおりです。

	平成17年度中間期 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日) (億円)	平成18年度中間期 (自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日) (億円)
(A) 営業キャッシュ・フロー	1,430	1,840
(B) 投資キャッシュ・フロー	△1,041	△1,190
(C) フリー・キャッシュ・フロー (A) + (B)	388	650
(D) 財務キャッシュ・フロー	△151	△735
(E) キャッシュ・フロー計 (C) + (D)	236	△84

2【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その容量、構造、形式等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしていません。

このため生産及び販売の状況については、「1. 業績等の概要」における各事業の種類別セグメント業績に関連付けて示しております。

3【対処すべき課題】

世界のIT投資は緩やかに増加しております。国内においても、業種や企業ごとで投資行動に差はあるものの、一般的に、緩やかではあります。IT投資に積極的な姿勢が見られるようになってきております。サービス市場においては、景気回復に伴い、緩やかな成長が見込まれます。一方、サーバやネットワーク機器などのプロダクトにおいては、低価格製品への需要シフトと価格低下の傾向があり、事業環境は厳しく推移すると見ております。今後も、当社グループは、厳しい環境下においても確実な利益と成長を実現できる収益力を目指します。

当社グループは、平成16年度より「既存ビジネスの徹底した体質強化」「新しい事業を創り、育てる」「フォーメーションの革新」「マネジメントシステムの革新」の4つのチャレンジ項目を掲げ、全社をあげて取り組んでおります。平成18年度は集大成として一層取り組みを強化してまいります。

(1) 既存ビジネスの徹底した体質強化

設計、開発、製造、営業などのあらゆる場面において、品質向上、原価低減、スピードアップに取り組んでおります。システム運用の品質については、昨年11月より開始した、お客様システムの総点検を引き続き行うことで、システム運用における信頼性向上のための取り組みを強化しております。また、ソフトウェアの受託開発については、SIAシチュアランス活動を通し不採算プロジェクトを抑制するとともに、開発における一層の効率化にも取り組んでまいります。ものづくりにおいては、これまで製造現場を中心に生産革新運動を進めてまいりましたが、これを設計や部品調達、販売といったサプライチェーン全体を視野に入れた取り組みに拡大してまいります。

サービス事業では、安定的な収益が見込まれる運用サービスビジネスとパッケージ・サービスビジネスを強化し、収益力の向上を目指します。また、サーバ/ストレージシステム/ネットワーク/ミドルウェアといったプロダクト事業では、機種ごとの拡販運動を積極的に推進するとともに、お客様自身でシステムを検証できる施設（プラットフォームソリューションセンター）の開設を国内及び海外で進めております。電子デバイス事業では、最先端65nmテクノロジーに対応した三重工場300mm第2棟の建設に着手し、平成19年4月の稼働を予定しております。また、平成18年9月にスパンション・ジャパン社より同社国内半導体工場の一部を購入する契約を締結いたしました。これにより基盤ロジック事業での収益を確保してまいります。

(2) 新しい事業を創り、育てる

当社が成長するためには、高い成長が望める海外市場における存在力を高めることが不可欠であると認識しております。昨年度の米国カリフォルニア、シンガポール、韓国に続き、今年度に入り、上海、香港に、お客様向けの検証施設を開設し、プラットフォーム事業の強化を図っております。また、米国EDS社との戦略的提携を活かしサーバの拡販に努めてまいります。サービス分野においては、ドイツSAP社との協業強化により、共同拡販プログラムを展開してまいります。

国内では、中堅・中小企業向けに、相互接続が可能な業種業務アプリケーションを体系的に提供するなど、今後成長が期待される市場に注力してまいります。

また、ITの活用は、企業のマネジメント系の領域から、調達、製造、販売といった企業活動の最前線や、教育や医療、娯楽など個人の社会生活の現場に浸透・拡大しつつあります。当社グループは、「フィールド・イノベーション」というコンセプトのもと、ITによる企業の現場の業務の革新や、より便利、快適、そして安心な社会の実現に取り組んでまいります。具体的には、最高水準のセキュリティを実現する非接触型手のひら静脈認証装置の世界展開や、流通の最前線などへさらなる活用が期待できるRFIDシステムなどの新規ビジネスをさらに開拓してまいります。

(3) フォーメーションの革新

お客様対応のスピードの向上及びITライフサイクル全体におけるワンストップでのサポートを実現するため、当社グループ全体でフォーメーションの革新に取り組んでおります。

国内ビジネスでは、パイプラインマネジメントにより、商談の進捗を把握し、お客様にとって最適な提案を行うなど、営業プロセスの革新に引き続き取り組んでおります。また、平成18年6月には海外ビジネスの推進体制を見直し、海外市場を4地域に区分するとともに、それぞれに総代表を設置いたしました。この体制のもと、地域の市場により密着し、海外拠点を中心とした迅速かつきめ細かなビジネスを進めてまいります。

(4) マネジメントシステムの革新

当社グループは、その目標、指針、行動規範を定めた「The FUJITSU Way」をその行動の原理/原則として、グループとしての持続可能性を重視した経営を進めており、経営効率の追求と、事業活動より生じるリスクのコントロールを同時に実現するためのコーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでおります。

現在、業務プロセスの改革と内部統制の強化を目的とした活動にグループをあげて取り組んでおり、これらを通じて引き続きグループとしての効率的かつ適法・適正な業務遂行体制の整備を進めてまいります。

また、「人が最大の財産である」という考えのもと、「人を育て、活かし、強くする」ことに向けた取り組みを継続して強化してまいります。

以上のような課題を不断の努力を積み重ねることにより解決し、お客様に信頼されるパートナーとなり、豊かで活力のあるネットワーク社会づくりに貢献できるグローバルな企業としてお客様や社会から信頼されるよう一層の自己革新を図ってまいります。

4【経営上の重要な契約等】

(1) 技術提携契約

当中間連結会計期間において、当社と米国IBM社（International Business Machines Corporation）は、平成8年10月23日に締結いたしました技術提携契約の更改契約を平成18年9月28日に締結いたしました。当該契約の内容は以下のとおりです。

契約会社名	相手方	国名	契約製品	契約内容	契約期間
富士通株式会社（当社）	International Business Machines Corporation	米国	情報処理組織	特許実施権交換	平成18年1月1日から関係特許の有効期間中

(2) 合弁契約及びその他の契約

契約会社名	相手方	国名	契約内容
富士通株式会社（当社）	Alcatel Participations	フランス	平成12年9月に左記会社（Alcatel社）との間で締結した契約に基づき設立した移動通信無線インフラ機器の合弁会社Evolium S.A.S.につき、平成18年7月28日に当社が保有するEvolium S.A.S.株式の全てをAlcatel社に譲渡するための株式譲渡契約を締結し、同年7月31日に譲渡を実施いたしました。これに伴ない左記会社との合弁契約を解消いたしました。同時に、新たな形態でのビジネス協力関係継続に係る契約を締結するとともに、平成12年11月締結の特許・ノウハウ実施交換契約も内容を見直しのうえ再締結いたしました。

5【研究開発活動】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、お客様のビジネスの発展やユビキタス社会の実現、環境への配慮を方針として、サービス、プロダクト、さらにこれらを支える半導体技術まで、様々な先端技術の研究開発を推進しております。

当中間連結会計期間におけるセグメント別の主な研究内容及び研究開発費は次のとおりです。なお、研究開発費については、下記のセグメント以外の「その他」セグメントの研究開発費3,986百万円のほか、フロンティア技術（ナノテクノロジー、ロボットなど）など、各セグメントに配賦していない基礎的試験研究費用等15,490百万円が含まれており、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は127,344百万円です。

a. テクノロジーソリューション

通信事業者向けを含め、オンライン処理システムでは、状況に応じてサービス負荷の大きな変動に対応する必要があります。従来の固定的なシステムでは、各サービスのピーク時の負荷にあわせてサーバをあらかじめ用意する必要があり、IT投資の効率化が課題となっておりました。この課題を解決するため、フランステレコム社と共同で、オンライン処理を含む各種サービスに必要なITリソースを効率的に利用するグリッドコンピューティング向けのミドルウェアGSP（Grid Service Platform）を開発し、その実証実験に成功いたしました。パリ、新宿、川崎に分散している24台の異なるメーカーのサーバを仮想的に統合し、サービスの負荷やビジネスの優先度に応じてサーバ間でリソースを自律的に割り振ることで、従来のシステムでは処理できなかった大きな負荷の変動に対しても対応可能であることを確認し、GSPの有効性を実証いたしました。GSPを活用することにより、オンライン処理システムにおいて、各サービスのピーク時の負荷にあわせてあらかじめ用意するサーバの台数を減らし、お客様のIT投資を効率化することが期待できます。

当セグメントに係る研究開発費は68,083百万円です。

b. ユビキタスプロダクトソリューション

HDD（ハードディスクドライブ）は、サーバやパソコンなどのIT機器から、DVDレコーダなどのAV機器まで、社会のさまざまなシーンで活用されており、デジタルのデータやコンテンツの増加に伴って、一層の大容量化が求められております。この度、当社は、独自に強い磁気を持つ磁気ヘッド新材料を開発し、そのメカニズムを解明いたしました。この新材料は、鉄・コバルトとパラジウムの薄膜を交互に積層したもので、今回、特殊なX線により、薄いパラジウムに隣接する部分で鉄・コバルトの磁化が促進されることにより、従来の材料に比べ約20%磁化しやすくなることが分かりました。これにより、今後、より高密度記録が可能な磁気ヘッドの実現を期待することができます。（本研究は、文部科学省のナノテクノロジー総合支援プロジェクトと、先端大型研究施設戦略活用プログラムの支援により、Spring-8放射光を用いて行われました。）

当セグメントに係る研究開発費は17,192百万円です。

c. デバイスソリューション

携帯電話などのモバイル機器を長い時間にわたって使用できるようにするためには、ロジックLSIの省電力化が必須となります。この度、45nm世代LSI向け技術として、ロジックLSIを構成する超微細なCMOSトランジスタの消費電力を、従来に比べ約30%低減する技術を開発いたしました。二層構造のゲート絶縁膜などの新技術により、リーク電流を低減すると同時に、信号電流の増加による高速動作を実現いたしました。これらにより、モバイル機器の長時間使用に加え、小型の機器でも高画質な映像処理が可能になります。

また、近年、IT機器が処理するデータ量の増加に伴って、サーバやストレージ、データセンターなど、情報処理システムの分散化が進んでおります。分散したシステムでは、機器間でギガビット/秒以上の大容量データを200m以上の距離にわたって伝送する必要があります。このため、独自に開発した3次元構造のポリマー光導波路を用い、3.125ギガビット/秒×4チャンネル構成で双方向通信が可能な小型・低価格な光トランシーバを富士通コンポーネント㈱と共同で開発いたしました。3次元ポリマー光導波路を用いて面発光レーザと光ファイバを低損失で簡便に接続する実装技術、複数の高速信号配線を小型化する技術の開発により、10ギガビット/秒で300mクラスの伝送を安価に実現いたしました。大容量の情報伝送が要求されるサーバやストレージ、データセンターなどで、機器間の接続コストを大幅に削減することができます。

当セグメントに係る研究開発費は22,593百万円です。